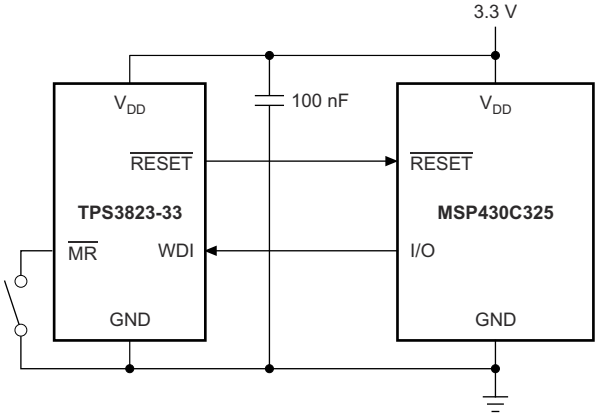
TPS382x 電圧モニタ、ウォッチドッグ・タイマ付き

1 特長

- 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS825、TPS3828) または 25ms (TPS3820) の固定遅延時間を持つパワーオン リセット ジェネレータ
- 手動リセット入力 (TPS3820、TPS3823、TPS825、TPS3828)
- アクティブ LOW (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS825)、アクティブ HIGH (TPS3824 および TPS825)、およびオープン ドレイン (TPS3828) で利用可能なリセット出力
- 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
- ウォッチドッグ タイマ (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828)
- 電源電流 15μA (標準値)
- 5 ピン SOT-23 パッケージ
- 温度範囲:-40℃～85℃ (TPS3823A-33 の場合 −40℃～125℃)

2 アプリケーション

- DSP、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
- 産業用機器
- プログラマブル制御
- 携帯型およびバッテリ駆動の機器
- 無線通信システム
- ノート PC およびデスクトップ PC



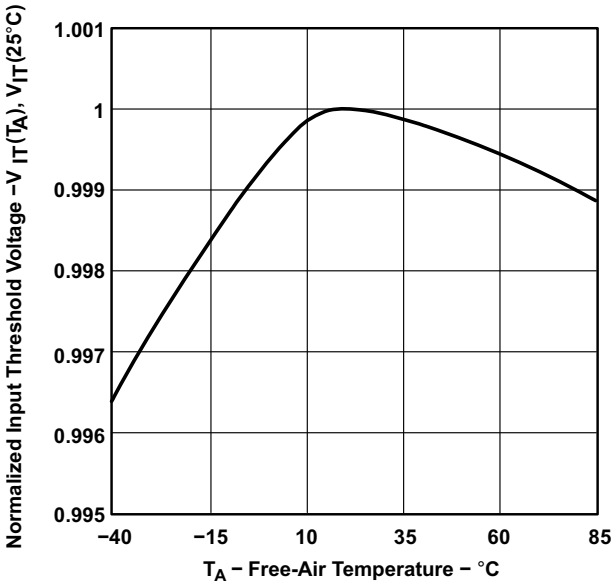
代表的なアプリケーション回路図

3 概要

TPS382x ファミリの電圧監視 IC は、主に DSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時に電源電圧 (V_{DD}) が 1.1V を上回ると、$\overline{RESET}$ がアサートされます。その後、監視回路は V_{DD} を監視し、V_{DD} がスレッショルド電圧 (V_{IT}) よりも低く保たれている限り、$\overline{RESET}$ をアクティブ LOW に維持します。内蔵のタイマは、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせて、適正なシステム リセットを発生させます。この遅延時間 t_d は、V_{DD} がスレッショルド電圧を上回るとスタートします (V_{IT-} + V_{HYS})。電源電圧がスレッショルド電圧 V_{IT-} を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 V_{IT-} が固定値になっています。また TPS382x ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820) または 1.6s (TPS3823、TPS3824、TPS3828) のいずれかを選択できます。

部品番号	パッケージ (1)	本体サイズ (公称)(2)
TPS382x	SOT-23 (5)	2.90mm × 1.60mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



正規化された入力スレッショルド電圧と自由通気温度との関係

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長.....1
2 アプリケーション.....1
3 概要.....1
4 デバイス比較表.....3
5 ピン構成および機能.....4
6 仕様.....5
6.1 絶対最大定格.....5
6.2 ESD 定格.....5
6.3 推奨動作条件.....5
6.4 熱に関する情報.....5
6.5 電気的特性.....6
6.6 電気的特性、TPS3823A-33 のみ.....7
6.7 タイミング要件.....8
6.8 スイッチング特性.....8
6.9 タイミング図.....8
6.10 標準的特性.....9
7 詳細説明.....14
7.1 概要.....14
7.2 機能ブロック図.....14
7.3 機能説明.....14
7.4 デバイスの機能モード.....15
8 アプリケーションと実装.....16
8.1 アプリケーション情報.....16
8.2 代表的なアプリケーション.....16
8.3 電源に関する推奨事項.....18
8.4 レイアウト.....18
9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....20
9.1 デバイスのサポート.....20
9.2 ドキュメントのサポート.....20
9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....20
9.4 サポート・リソース.....21
9.5 商標.....21
9.6 静電気放電に関する注意事項.....21
9.7 用語集.....21
10 改訂履歴.....21
11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....22

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

4 デバイス比較表

デバイス	リセット	RESET	WDI	$\overline{\text{MR}}$
TPS3820		プッシュプル	X	X
TPS3823		プッシュプル	X	X
TPS3823A		プッシュプル	X	X
TPS3824	プッシュプル	プッシュプル	X	
TPS3825	プッシュプル	プッシュプル		X
TPS3828		オープンドレイン	X	X

5 ピン構成および機能

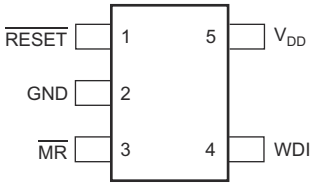


図 5-1. 5 ピン SOT-23 TPS3820、TPS3823、TPS3823A、TPS3828：DBV パッケージ (上面図)

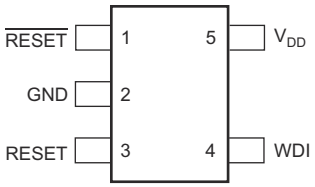


図 5-2. 5 ピン SOT-23 TPS3824：DBV パッケージ (上面図)

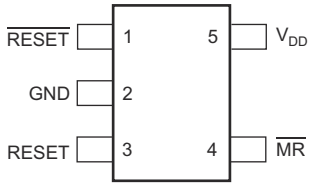


図 5-3. 5 ピン SOT-23 TPS3825：DBV パッケージ (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン				I/O	説明
名称	TPS3820、TPS3823、TPS3823A、TPS3828	TPS3824	TPS3825		
GND	2	2	2	—	グランド接続
$\overline{MR}$	3	—	4	I	マニュアル リセット入力 LOW にすると、強制的にリセットされます。$\overline{MR}$ が LOW の間、および $\overline{MR}$ が HIGH になった後のタイムアウト期間中、$\overline{RESET}$ は LOW のまま維持されます。使用しない場合は、未接続のままにするか、または V_{DD} に接続します。
リセット	—	3	3	O	アクティブ HIGH リセット出力。プッシュプルまたはオープン ドレイン出力段のいずれかです。
$\overline{RESET}$	1	1	1	O	アクティブ LOW リセット出力。プッシュプルまたはオープン ドレイン出力段のいずれかです。
V_{DD}	5	5	5	I	電源電圧。デバイスに電力を供給し、デバイスの電圧を監視します。
WDI	4	4	—	I	ウォッチドッグ タイマ入力。WDI がタイムアウト期間よりも長い間 HIGH または LOW のままの場合、リセットがトリガされます。リセットがアサートされるか、WDI が立ち下がりエッジを検出すると、タイマはクリアされます。フローティング状態のままにすると、デバイスはウォッチドッグ リセット イベントを防止するため内部でパルスを生成します。ウォッチドッグ エラーで出力をアサートするには、WDI を LOW または HIGH に駆動する必要があります。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) [(1)]

		最小値	最大値	単位
電圧	VDD	-0.3	6	V
	RESET、$\overline{\text{RESET}}$、$\overline{\text{MR}}$、WDI	-0.3	V_{DD} + 0.3	V
電流	最大 LOW 出力、I_{OL}	-5	5	mA
	最大 HIGH 出力、I_{OH}	-5	5	mA
	出力範囲 (V_O < 0 または V_O > V_{DD})、I_{OK}	-10	10	mA
温度	自由気流での動作温度 (T_A)	-40	85	℃
	自由気流での動作温度、T_A、TPS3823A-33 の場合のみ	-40	125	℃
	保管温度範囲、T_{stg}	-65	150	℃

(1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらは、ストレス定格のみを示すものであり、これらの条件や「推奨動作条件」に示された値を超える条件で、本製品が機能することを意味するものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を及ぼす場合があります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠[(1)]	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠[(2)]	±500	

(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V_{DD}	電源電圧	1.1		5.5	V
V_{IH}	$\overline{\text{MR}}$ および WDI の HIGH レベル入力電圧	0.7 × V_{DD}			V
V_{IL}	Low レベル入力電圧			0.3 × V_{DD}	V
Δt/ΔV	$\overline{\text{MR}}$ または WDI の入力遷移の立ち上がりおよび立ち下がりレート			100	ns/V
T_A	動作温度範囲	-40		85	℃
T_A	自由気流での動作温度範囲 (TPS3823A-33 の場合のみ)	-40		125	℃

6.4 熱に関する情報

熱評価基準[(1)]		TPS382x DBV (SOT-23) 5 ピン
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	185
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	83.3
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	52.4
ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	20.4
ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	52.0
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

6.5 電気的特性

動作温度範囲 −40℃ ～ 85℃ (特に記述のない限り)。

	パラメータ			テスト条件	最小値	公称値	最大値	単位
V_{OH}	High レベル出力電圧	$\overline{RESET}$	TPS382x-25	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$、$I_{OH} = -20\mu A$		0.8 × V_{DD}		V
			TPS382x-30	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$、$I_{OH} = -30\mu A$				
			TPS382x-33					
			TPS382xA-33					
			TPS382x-50	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$, $I_{OH} = -120\mu A$	$V_{DD} - 1.5V$			
		リセット	TPS3824-25 TPS3825-25	$V_{DD} \geq 1.8V$、$I_{OH} = -100\mu A$		0.8 × V_{DD}		
			TPS3824-30 TPS3825-30	$V_{DD} \geq 1.8V$、$I_{OH} = -150\mu A$				
			TPS3824-33 TPS3825-33					
			TPS3824-50 TPS3825-50					
V_{OL}	Low レベル出力電圧	リセット	TPS3824-25 TPS3825-25	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$、$I_{OL} = 1mA$			0.4	V
			TPS3824-30 TPS3825-30	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$、$I_{OL} = 1.2mA$				
			TPS3824-33 TPS3825-33					
			TPS3824-50 TPS3825-50	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$、$I_{OL} = 3mA$				
		$\overline{RESET}$	TPS382x-25	$V_{DD} = V_{IT-} - 0.2V$、$I_{OL} = 1mA$			0.4	
			TPS382x-30	$V_{DD} = V_{IT-} - 0.2V$、$I_{OL} = 1.2mA$				
			TPS382x-33 TPS382xA-33					
			TPS382x-50	$V_{DD} = V_{IT-} - 0.2V$、$I_{OL} = 3mA$				
V_{POR}	パワーアップ リセット電圧[(1)]			$V_{OL(max)} = 0.4V$、$I_{OL(Sink)} = 20\mu A$			0.9	V
V_{IT-}	負方向の入力スレッショルド電圧 [(2)]		TPS382x-25	T_A = 0℃～85℃	2.21	2.25	2.30	V
			TPS382x-30		2.59	2.63	2.69	
			TPS382x-33 TPS382xA-33		2.88	2.93	3.00	
			TPS382x-50		4.49	4.55	4.64	
			TPS382x-25	T_A = –40℃～85℃	2.20	2.25	2.30	
			TPS382x-30		2.57	2.63	2.69	
			TPS382x-33 TPS382xA-33		2.86	2.93	3.00	
			TPS382x-50		4.46	4.55	4.64	
V_{HYS}	V_{DD} 入力でのヒステリシス		TPS382x-25			30		mV
			TPS382x-30					
			TPS382x-33 TPS382xA-33					
			TPS382x-50			50		
$I_{IH(AV)}$	HIGH レベル平均入力電流		WDI	WDI = V_{DD}、時間平均 (DC = 88%)		120		μA
$I_{IL(AV)}$	LOW レベル平均入力電流			WDI = 0.3V、V_{DD} = 5.5V、時間平均 (DC = 12%)		-15		
I_{IH}	High レベル入力電流	WDI		WDI = V_{DD}		140	190	μA
		$\overline{MR}$		$\overline{MR}$ = 0.7 × V_{DD}、V_{DD} = 5.5V		-40	-60	

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

6.5 電気的特性 (続き)

動作温度範囲 −40℃ ～ 85℃ (特に記述のない限り)。

	パラメータ			テスト条件	最小値	公称値	最大値	単位
I_{IL}	Low レベル入力電流	WDI		WDI = 0.3V, V_{DD} = 5.5V		140	190	μA
		$\overline{MR}$		$\overline{MR}$ = 0.3V, V_{DD} = 5.5V		-110	-160	
I_{OS}	出力短絡電流 (3)	$\overline{RESET}$	TPS382x-25	V_{DD} = $V_{IT-,max}$ + 0.2V、V_O = 0V			-400	μA
			TPS382x-30					
			TPS382x-33 TPS382xA-33					
			TPS382x-50				-800	
I_{DD}	電源電流			WDI、$\overline{MR}$、および出力は未接続		15	25	μA
R_{MR}	$\overline{MR}$ の内部プルアップ抵抗					90		kΩ
C_i	$\overline{MR}$、WDI の入力容量			V_I = 0V～5.5V		5		pF

(1) $\overline{RESET}$ がアクティブになる最小電源電圧。t_r、V_{DD} ≥ 15μs/V。
(2) スレッショルド電圧の安定性を最大限に確保するため、バイパス コンデンサ (セラミック、0.1μF) を電源端子の近くに配置する必要があります。
(3) $\overline{RESET}$ 短絡電流は、マイクロプロセッサの双方向リセット ピンによって $\overline{RESET}$ が LOW に駆動されたときの最大プルアップ電流です。

6.6 電気的特性、TPS3823A-33 のみ

動作温度範囲 –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)

	パラメータ			テスト条件	最小値	公称値	最大値	単位
V_{OH}	High レベル出力電圧	$\overline{RESET}$		V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V、I_{OH} = –30μA	0.8 × V_{DD}			V
V_{OL}	Low レベル出力電圧	$\overline{RESET}$		V_{DD} = V_{IT-} – 0.2V、I_{OL} = 1.2mA			0.45	V
V_{POR}	パワーアップ リセット電圧 (1)			$V_{OL(max)}$ = 0.4V、$I_{OL(Sink)}$ = 20μA			0.9	V
V_{IT-}	負方向の入力スレッショルド電圧 (2)				2.83	2.93	3.00	V
V_{HYS}	V_{DD} 入力でのヒステリシス					30		mV
$I_{IH(AV)}$	HIGH レベル平均入力電流		WDI	WDI = V_{DD}、時間平均 (DC = 88%)		120		μA
$I_{IL(AV)}$	LOW レベル平均入力電流			WDI = 0.3V、V_{DD} = 5.5V、時間平均 (DC = 12%)		-15		
I_{IH}	High レベル入力電流	WDI		WDI = V_{DD}		140	190	μA
		$\overline{MR}$		$\overline{MR}$ = 0.7 × V_{DD}、V_{DD} = 5.5V		-40	-60	
I_{IL}	Low レベル入力電流	WDI		WDI = 0.3V, V_{DD} = 5.5V		140	190	μA
		$\overline{MR}$		$\overline{MR}$ = 0.3V, V_{DD} = 5.5V		-110	-160	
I_{OS}	出力短絡電流 (3)	$\overline{RESET}$		V_{DD} = $V_{IT-,max}$ + 0.2V、V_O = 0V			-400	μA
I_{DD}	電源電流			WDI、$\overline{MR}$、および出力は未接続		15	25	μA
R_{MR}	$\overline{MR}$ の内部プルアップ抵抗					90		kΩ
C_i	$\overline{MR}$、WDI の入力容量			V_I = 0V～5.5V		5		pF

(1) $\overline{RESET}$ がアクティブになる最小電源電圧。t_r、V_{DD} ≥ 15μs/V。
(2) スレッショルド電圧の安定性を最大限に確保するため、バイパス コンデンサ (セラミック、0.1μF) を電源端子の近くに配置する必要があります。
(3) $\overline{RESET}$ 短絡電流は、マイクロプロセッサの双方向リセット ピンによって $\overline{RESET}$ が LOW に駆動されたときの最大プルアップ電流です。

6.7 タイミング要件

R_L = 1MΩ、C_L = 50pF および T_A = 25℃ (特に記述のない限り)。

	パラメータ		テスト条件	最小値	公称値	最大値	単位
t_W	パルス幅	V_{DD}	$V_{DD} = V_{IT-} + 0.2V$、$V_{DD} = V_{IT-} – 0.2V$	6			μs
		$\overline{MR}$	$V_{DD} \geq V_{IT-} + 0.2V$、$V_{IL} = 0.3 \times V_{DD}$、$V_{IH} = 0.7 \times V_{DD}$	1			μs
		WDI		100			ns

6.8 スイッチング特性

R_L = 1MΩ、C_L = 50pF および T_A = 25℃ (特に記述のない限り)。

	パラメータ		テスト条件	最小値	公称値	最大値	単位
t_{tout}	ウォッチドッグ タイムアウト	TPS3820	$V_{DD} \geq V_{IT-} + 0.2V$、タイミング図を参照	112	200	300	ms
		TPS3823/4/8, TPS3823A		0.9	1.6	2.5	s
t_d	遅延時間	TPS3820	$V_{DD} \geq V_{IT-} + 0.2V$、タイミング図を参照	15	25	37	ms
		TPS3823/4/5/8, TPS3823A		120	200	300	
t_{PHL}	伝搬遅延時間、High から Low 出力	$\overline{MR}$ から $\overline{RESET}$ までの遅延 (TPS3820/3/5/8、TPS3823A)	$V_{DD} \geq V_{IT-} + 0.2V$、$V_{IL} = 0.3 \text{ x } V_{DD}$、$V_{IH} = 0.7 \text{ x } V_{DD}$			0.1	μs
		V_{DD} から $\overline{RESET}$ までの遅延	$V_{IL} = V_{IT-} – 0.2V$、$V_{IH} = V_{IT-} + 0.2V$			25	μs
t_{PLH}	伝搬遅延時間、Low から High 出力	$\overline{MR}$ から RESET までの遅延 (TPS3824/5)	$V_{DD} \geq V_{IT-} + 0.2V$、$V_{IL} = 0.3 \text{ x } V_{DD}$、$V_{IH} = 0.7 \text{ x } V_{DD}$			0.1	μs
		V_{DD} から RESET までの遅延 (TPS3824/5)	$V_{IL} = V_{IT-} – 0.2V$、$V_{IH} = V_{IT-} + 0.2V$			25	μs

6.9 タイミング図

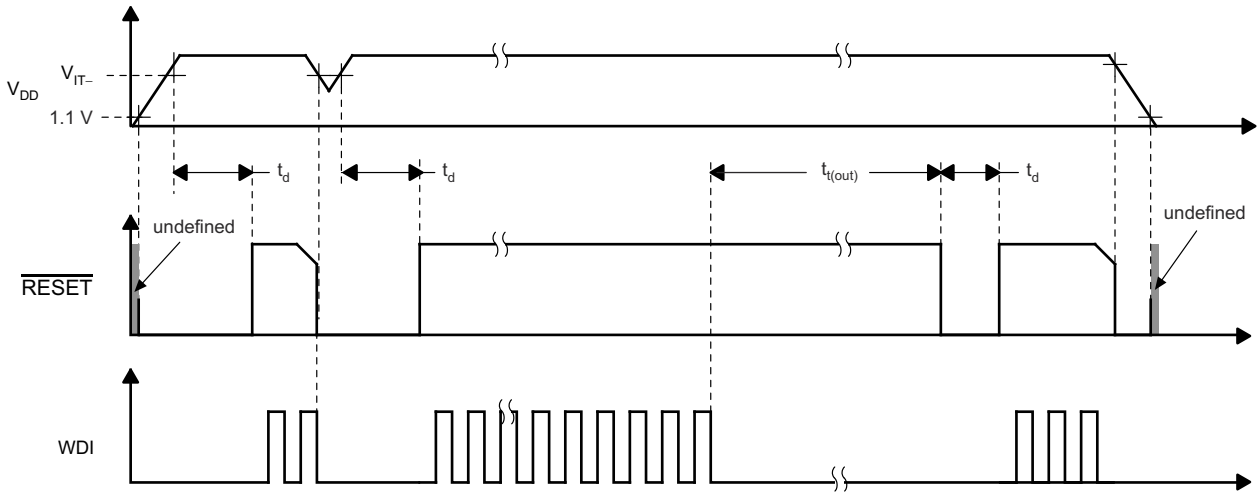


図 6-1. タイミング図

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

6.10 標準的特性

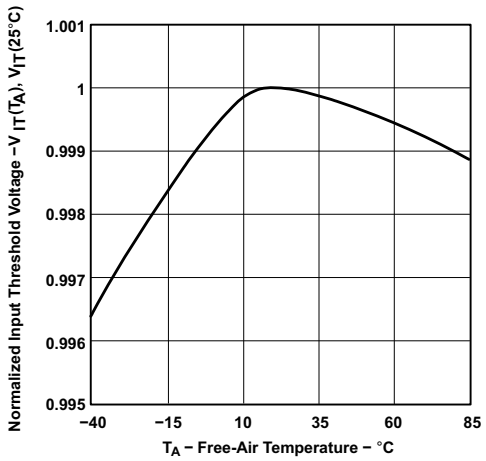


図 6-2. 正規化された入力スレッショルド電圧と V_{DD} での自由通気温度との関係

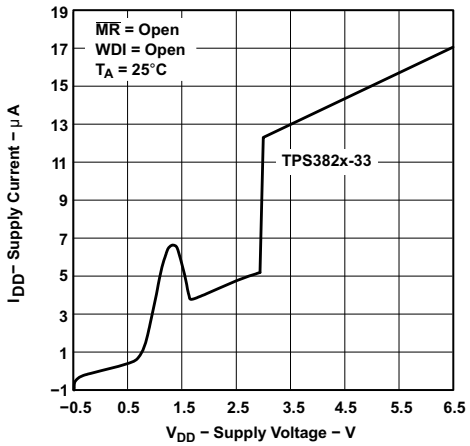


図 6-3. 消費電流と電源電圧との関係

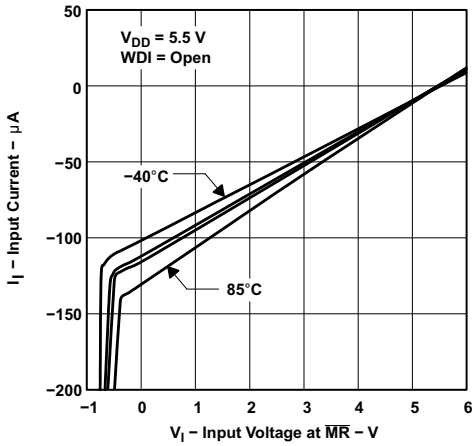


図 6-4. $\overline{MR}$ の入力電流と入力電圧との関係

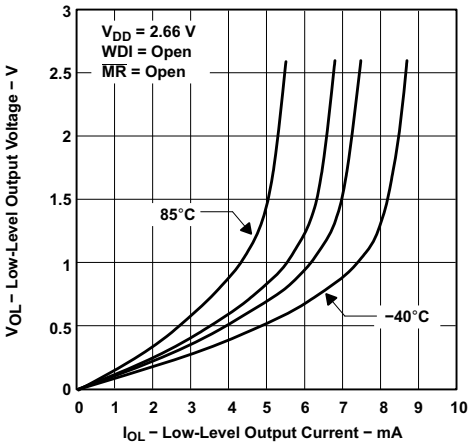


図 6-5. LOW レベル出力電圧と LOW レベル出力電流との関係

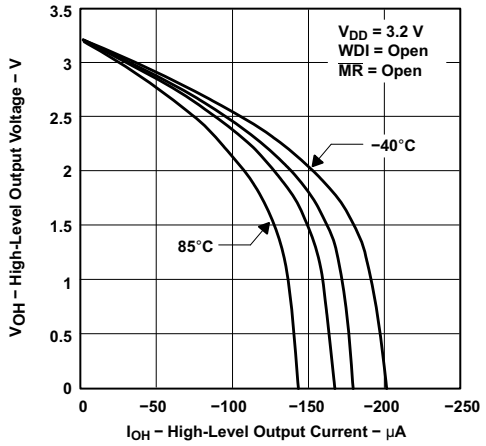


図 6-6. HIGH レベル出力電圧と HIGH レベル出力電流との関係

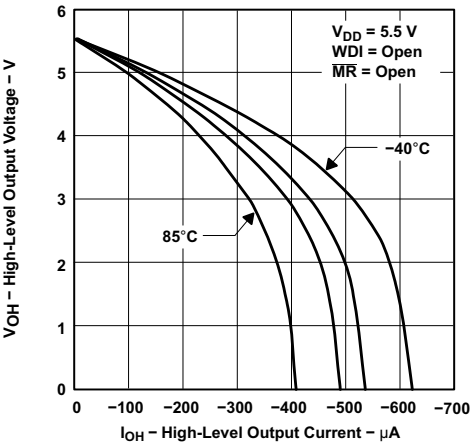


図 6-7. HIGH レベル出力電圧と HIGH レベル出力電流との関係

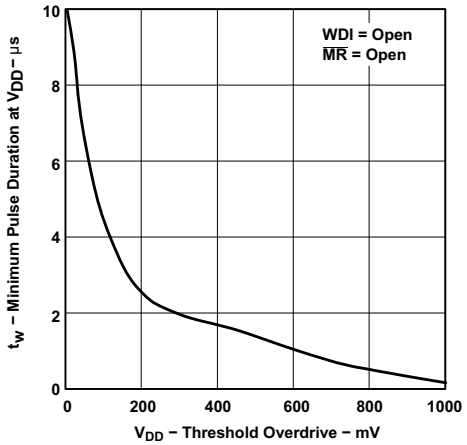


図 6-8. V_{DD} の最小パルス幅と V_{DD} スレッショルド・オーバードライブとの関係

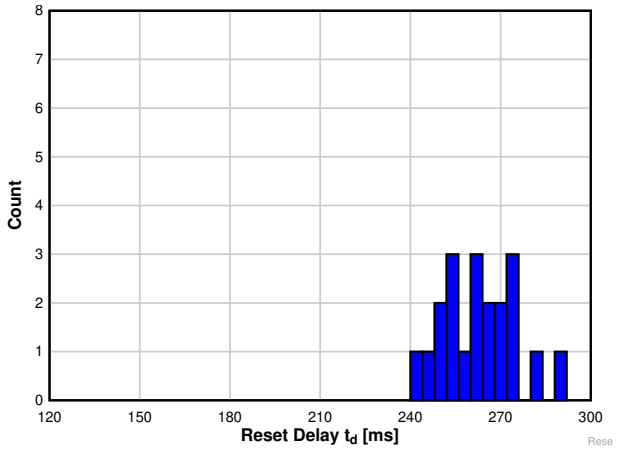


図 6-9. -40℃での TPS3823A-33 デバイスのリセット遅延ヒストグラム (ユニット数 = 20)

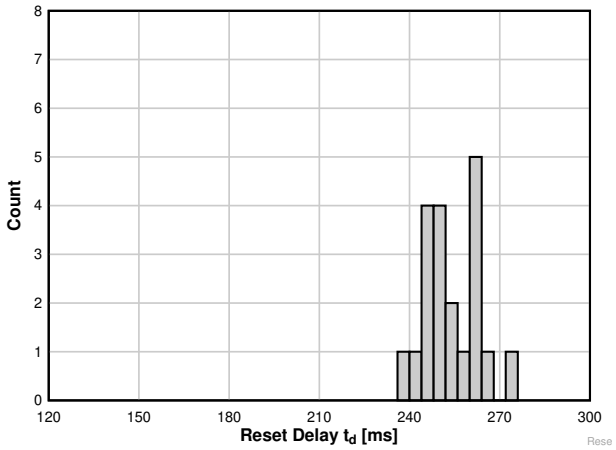


図 6-10. 25℃での TPS3823A-33 デバイスのリセット遅延ヒストグラム (ユニット数 = 20)

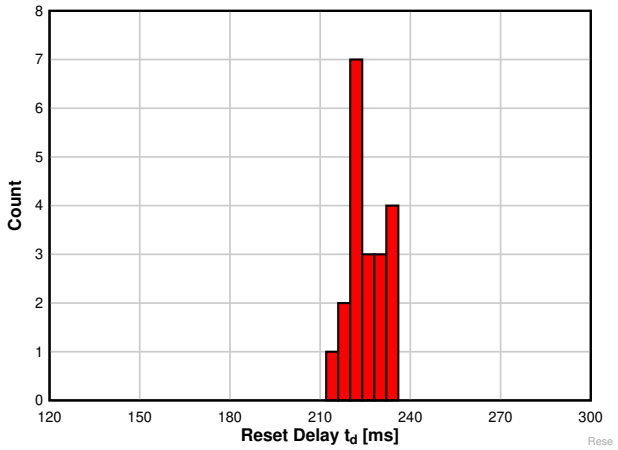


図 6-11. 125℃での TPS3823A-33 デバイスのリセット遅延ヒストグラム (ユニット数 = 20)

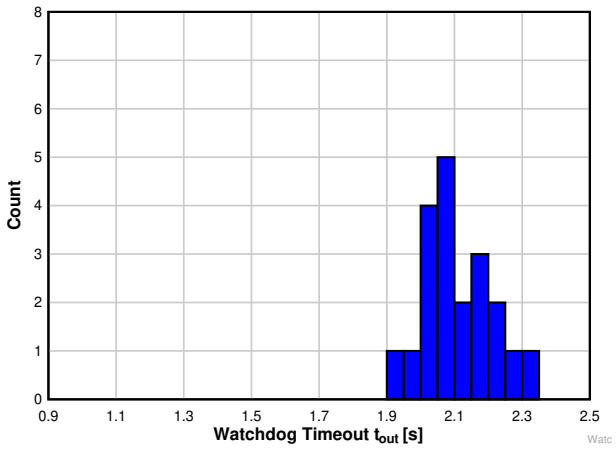


図 6-12. -40℃での TPS3823A-33 デバイスのウォッチドッグ・タイムアウト・ヒストグラム (ユニット数 = 20)

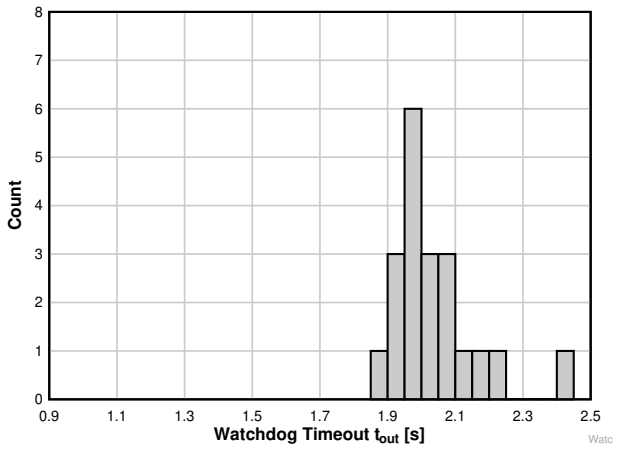


図 6-13. 25℃での TPS3823A-33 デバイスのウォッチドッグ・タイムアウト・ヒストグラム (ユニット数 = 20)

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

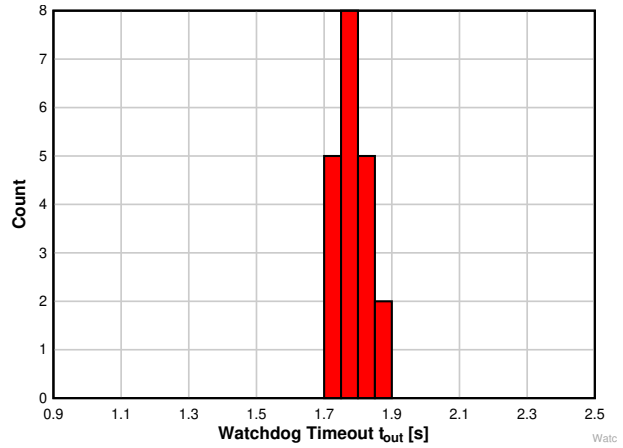


図 6-14. 125℃での TPS3823A-33 デバイスのウォッチドッグ・タイムアウト・ヒストグラム (ユニット数 = 20)

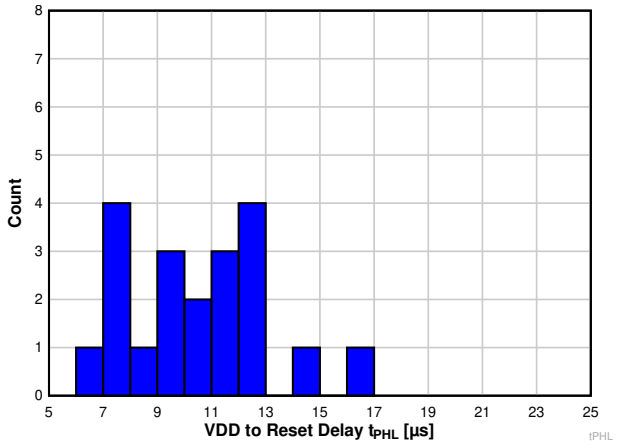


図 6-15. -40℃での TPS3823A-33 デバイスの VDD からリセットまでの遅延ヒストグラム (ユニット数 = 20)

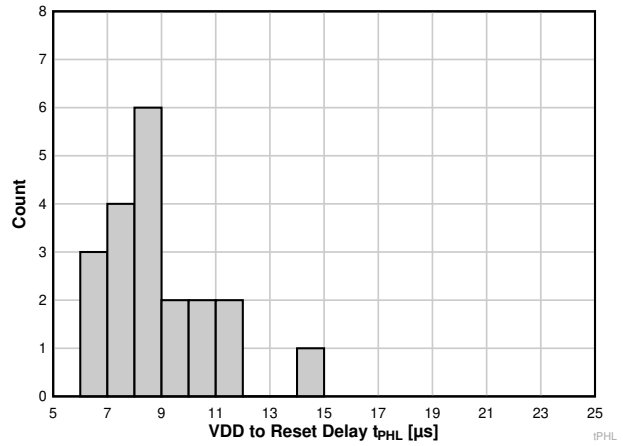


図 6-16. 25℃での TPS3823A-33 デバイスの VDD からリセットまでの遅延ヒストグラム (ユニット数 = 20)

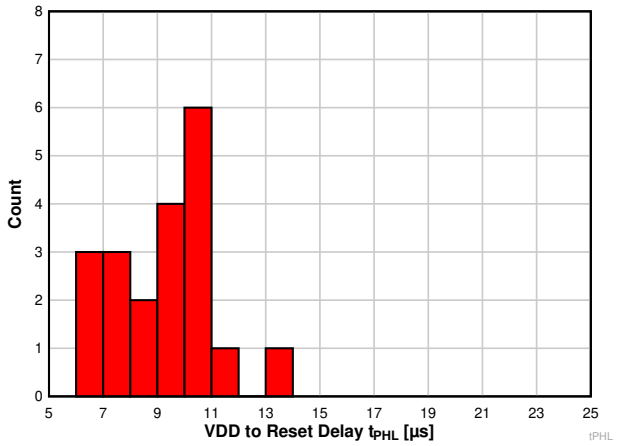


図 6-17. 125℃での TPS3823A-33 デバイスの VDD からリセットまでの遅延ヒストグラム (ユニット数 = 20)

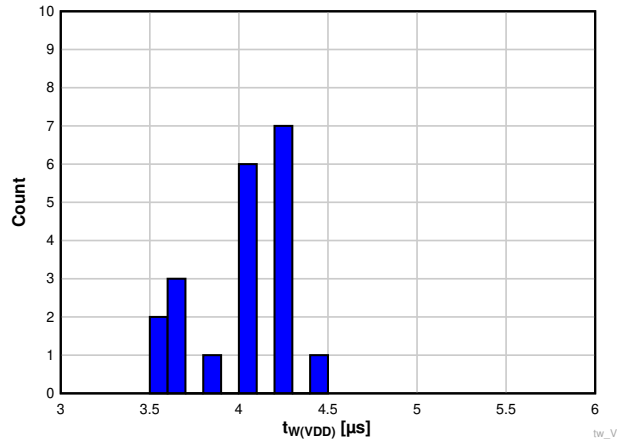


図 6-18. -40℃での TPS3823A-33 デバイスの VDD パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

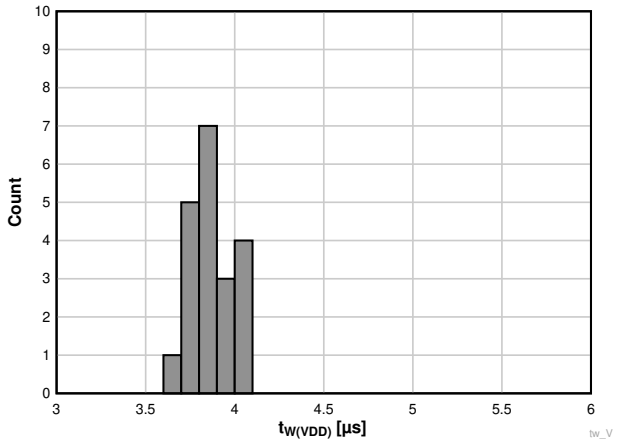


図 6-19. 25℃での TPS3823A-33 デバイスの VDD パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

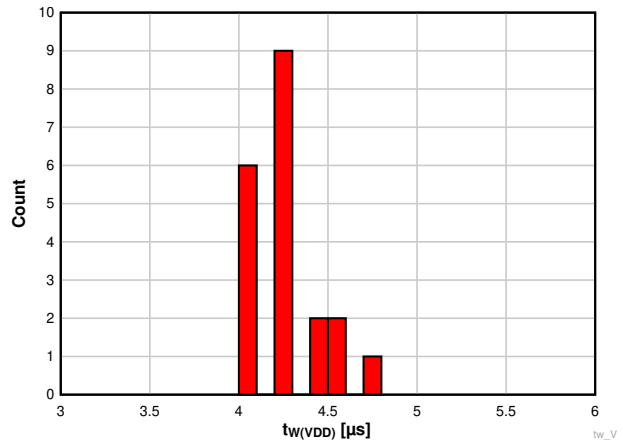


図 6-20. 125℃での TPS3823A-33 デバイスの VDD パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

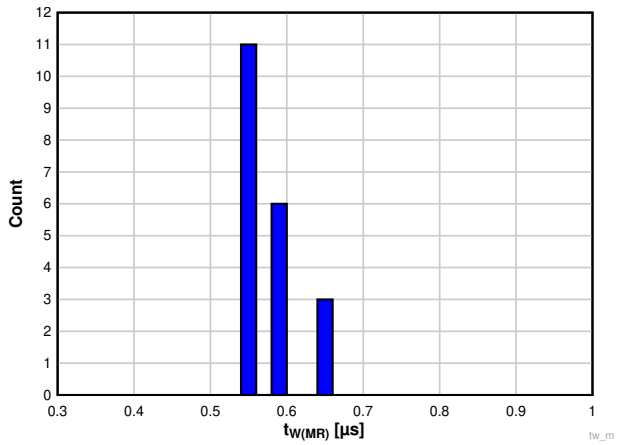


図 6-21. -40℃での TPS3823A-33 デバイスのマニュアル・リセット・パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

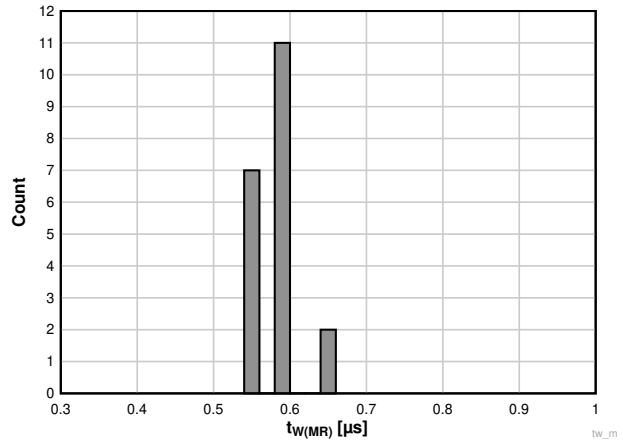


図 6-22. 25℃での TPS3823A-33 デバイスのマニュアル・リセット・パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

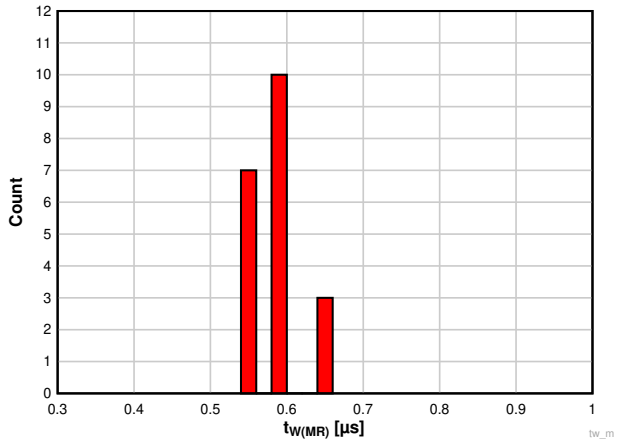


図 6-23. 125℃での TPS3823A-33 デバイスのマニュアル・リセット・パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

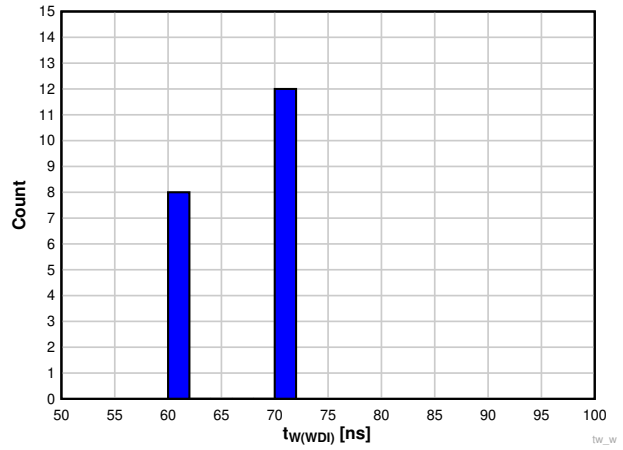


図 6-24. -40℃での TPS3823A-33 デバイスの WDI パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

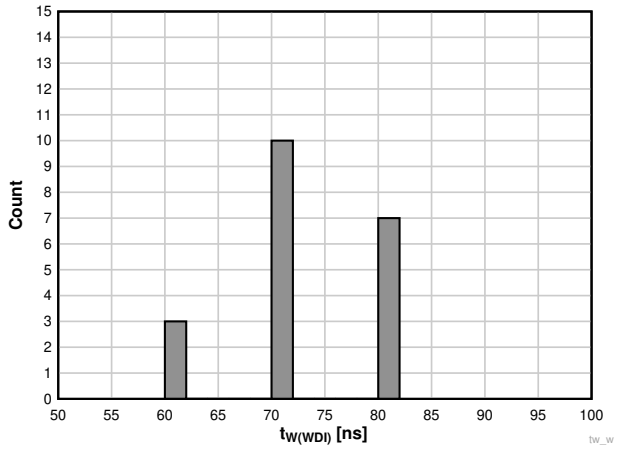


図 6-25. 25℃での TPS3823A-33 デバイスの WDI パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

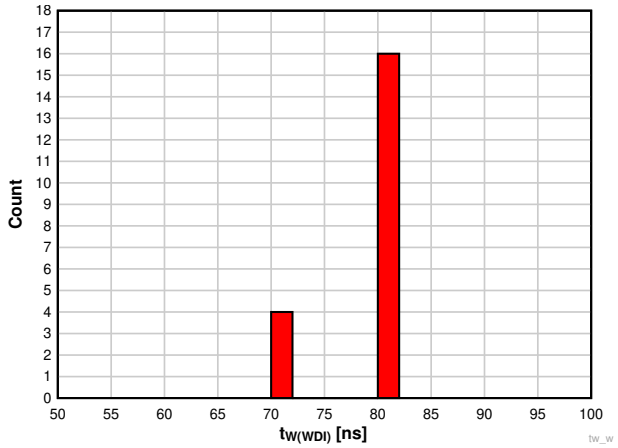


図 6-26. 125℃での TPS3823A-33 デバイスの WDI パルス幅ヒストグラム (ユニット数 = 20)

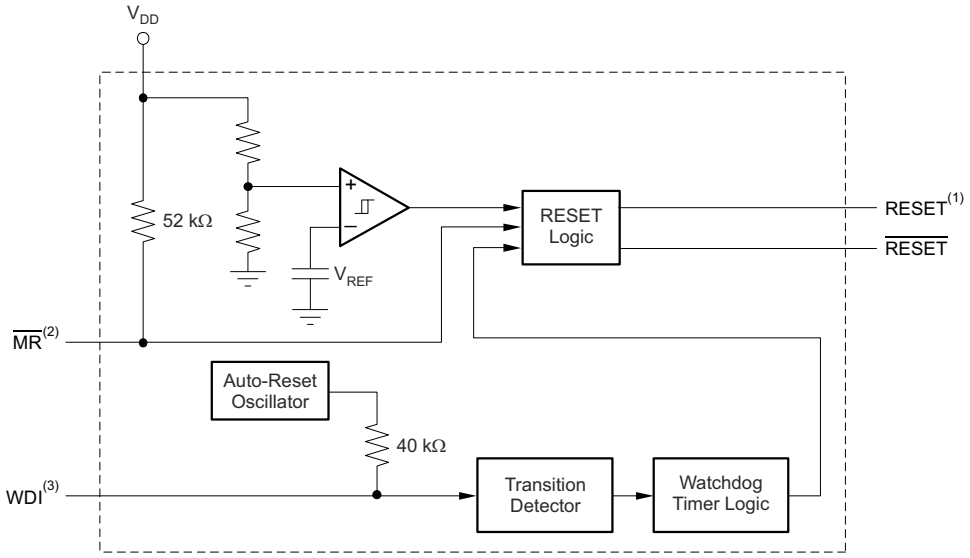
7 詳細説明

7.1 概要

TPS382x ファミリの電圧監視 IC は、回路の初期化およびタイミングの監視を行います。オプションの構成として、アクティブ HIGH およびアクティブ LOW の出力信号を持つデバイス (TPS3824/5) 、ウォッチドッグ タイマを搭載したデバイス (TPS3820/3/4/8) 、マニュアル リセット ($\overline{MR}$) ピンを搭載したデバイス (TPS3820/3/5/8) があります。$\overline{RESET}$ は、電源電圧 (V_{DD}) が 1.1V を上回るとアサートされます。アクティブ LOW 出力ロジックを備えたデバイスの場合、デバイスは V_{DD} を監視し、V_{DD} が負のスレッショルド電圧 V_{IT-} を下回っている間、$\overline{RESET}$ を LOW に維持します。アクティブ HIGH 出力ロジックを備えたデバイスの場合、V_{DD} が V_{IT-} を下回っている間、RESET を HIGH に維持します。内蔵のタイマは、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせて、適正なシステム リセットを発生させます。この遅延時間 t_d は、V_{DD} がスレッショルド電圧 (V_{IT-} + V_{HYS}) を上回るとスタートします。電源電圧がスレッショルド電圧 V_{IT-} を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 V_{IT-} が固定値になっています。したがって、外付け部品は不要です。

TPS382x ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧を監視するように設計されています。これらのデバイスは 5 ピン SOT-23 パッケージで供給され、−40℃ ～ 85℃の温度範囲で動作が規定されています TPS3823A-33 のみ、−40℃ ～ 125℃の温度範囲で動作が規定されています。

7.2 機能ブロック図



A. TPS3824/5
B. TPS3820/3/5/8
C. TPS3820/3/4/8

7.3 機能説明

7.3.1 マニュアル・リセット ($\overline{MR}$)

プロセッサ、ロジック回路、ディスクリート・センサからの外部ロジック信号を $\overline{MR}$ 入力で使用することにより、V_{IT-} に対する V_{DD} の状態、またはウォッチドッグ・タイマの状態に関係なく、リセット信号を強制的に生成できます。$\overline{MR}$ が LOW レベルのとき、リセット信号がアクティブになります。

7.3.2 アクティブ HIGH またはアクティブ LOW の出力

すべての TPS382x デバイスにはアクティブ LOW ロジック出力 ($\overline{RESET}$) があり、TPS3824/5 デバイスにはアクティブ HIGH ロジック出力 (RESET) もあります。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

7.3.3 プッシュプルまたはオープンドレイン出力

TPS3828 を除くすべての TPS382x デバイスは、プッシュプル出力を備えています。TPS3828 デバイスは、オープン・ドレイン出力を備えています。

7.3.4 ウォッチドッグ タイマ (WDI)

TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828 デバイスにはウォッチドッグ タイマがあり、リセット信号の発行を避けるために、WDI 信号を負に遷移させて定期的にトリガする必要があります。監視対象のシステムがタイムアウト期間 t_{tout} 内にウォッチドッグ回路を再トリガしない場合、$\overline{RESET}$ は、期間 t_d にわたってアクティブになります。また、このイベントは、ウォッチドッグ タイマを再初期化します。

ウォッチドッグ タイマは、WDI ピンをシステムから切断することで無効にできます。WDI ピンが高インピーダンス状態であることを検出すると、TPS3820、TPS3823、TPS3824、または TPS3828 は、$\overline{RESET}$ がアサートされないようにするため、内部 WDI パルスを生成します。この動作が望ましくない場合は、WDI とグランドの間に 1kΩ の抵抗を接続します。この抵抗により、TPS3820、TPS3823、TPS3824、または TPS3828 は、WDI が高インピーダンス状態でないことを検出できます。

WDI ピンへの入力がアクティブ (HIGH と LOW の間を遷移) であり、TPS3820、TPS3823、TPS3824、または TPS3828 が $\overline{RESET}$ をアサートしているアプリケーションでは、入力電圧が V_{IT-} を超えた後も、$\overline{RESET}$ は ロジック LOW に固定されたままです。リセット信号がアサートされているときにもアプリケーションが WDI への入力をアクティブにする必要がある場合は、デバイスの **A** バージョンまたは FET を使用して WDI 信号をデカップリングする必要があります。リセットがアサートされている間に WDI パルスを受信した場合、**A** バージョンはリセット信号をアサート状態にラッチしません。外付け FET は、$\overline{RESET}$ がアサートされたときに WDI 入力を切断することで WDI 信号をデカップリングします。詳細については、「*リセット イベント中の WDI デカップリング*」を参照してください。**A** バージョンは、システム内の FET 有無に関わらず動作します。したがって、**A** バージョン は、**A** 以外のバージョンと下位互換性があります。

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1 に、TPS382x デバイスの機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力		出力	
$\overline{MR}$ (1)	$V_{DD} > V_{IT}$	$\overline{RESET}$	$\overline{RESET}$(2)
L	0	L	H
L	1	L	H
H	0	L	H
H	1	H	L

(1) TPS3820/3/5/8
(2) TPS3824/5

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

TPS382x デバイス ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の固定電源電圧を監視する超小型の監視回路です。TPS382x ファミリは 1.1V ～ 5.5V で動作します。注文可能なオプションには、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力のバージョン、出力信号にアクティブ HIGH またはアクティブ LOW ロジックを使用するバージョン、マニュアル リセット ピン付きのバージョン、ウォッチドッグ タイマ付きのバージョンがあります。デバイス ファミリの概要については、*「デバイス比較表」*を参照してください。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 ウォッチドッグ タイムアウトおよび 200ms 遅延付きの電源レール監視

TPS3823A は、マイクロコントローラなどのデバイスの電源レールの監視に使用できます。電源ピン (V_{DD}) の電圧が内部スレッショルド電圧 (V_{IT-} + V_{HYS}) を上回ると、TPS3823A は下流側のデバイスをイネーブルにします。TPS3823A は、V_{DD} がスレッショルド電圧からヒステリシス電圧 (V_{IT-}) を引いた値を下回ると、下流側のデバイスをディセーブルにします。また、WDI の立ち上がりまたは立ち下がりによって WDI 入力が定期的にトリガされない場合、TPS3823A は リセット信号を発行します。監視対象のシステムがタイムアウト期間 t_{tout} 内にウォッチドッグ回路を再トリガしない場合、$\overline{RESET}$ は、期間 t_d にわたってアクティブになります。

一部のアプリケーションで必要とされるリセット信号は、TPS382x ファミリの大部分が提供している 200ms よりも短いものです。このような場合、TPS3820 は遅延時間がわずか 25ms であるため、適切な選択肢になります。オープン ドレイン出力が必要な場合は、TPS3823A を TPS3828 に置き換えます ($\overline{RESET}$ が LOW のときに WDI 入力をアクティブにする必要がある場合は、「*リセット イベント中の WDI デカップリング*」を参照)。図 8-1 に代表的なアプリケーションにおける TPS3823A を示します。

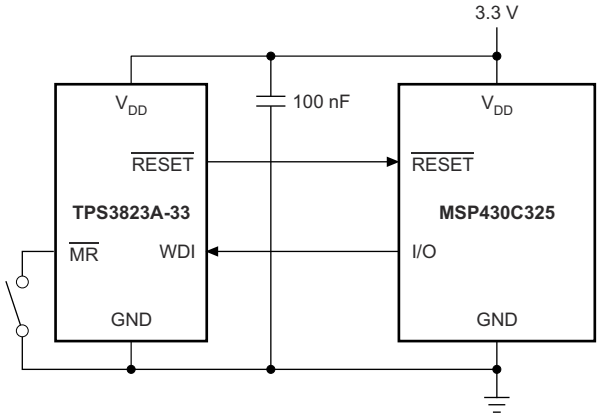


図 8-1. ウォッチドッグ タイムアウト付きの電源レール監視

8.2.1.1 設計要件

TPS3823A は、ロジック HIGH 信号を使用して MSP430C325 のイネーブル・ピンを駆動し、電源電圧がデバイスの最小動作電圧を上回っていることを示すとともに、I/O ピンを監視してマイクロコントローラが正常に動作しているかどうかを確認する必要があります。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

8.2.1.2 詳細な設計手順

必要な機能の遂行に最適な TPS382x ファミリのバージョンを決定します。

入力電源にノイズが多い場合は、リセット信号が不用意に変化することを防止するために、入力コンデンサを付けてください。

8.2.1.3 アプリケーション曲線

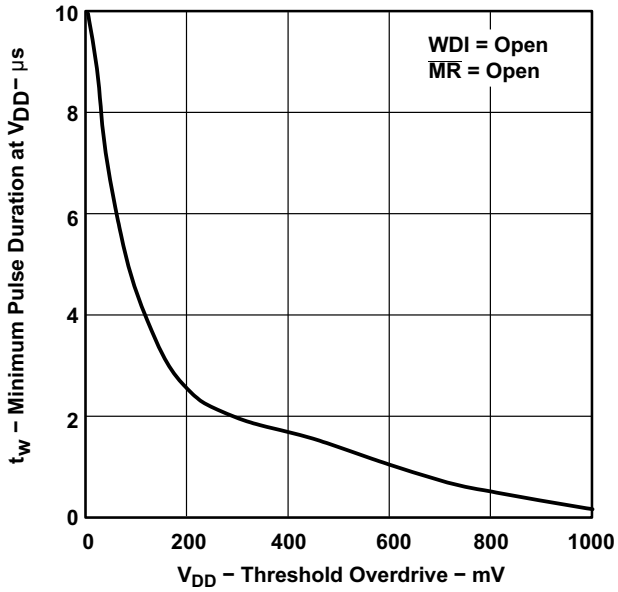


図 8-2. V_{DD} の最小パルス幅と V_{DD} スレッショルド・オーバードライブとの関係

8.2.2 リセット・イベント中の WDI デカップリング

リセット信号がアサートされているときに WDI への入力がアクティブであることがアプリケーションで要求され、デバイスの **A** バージョンを使用できない場合に、N チャネル FET を使って WDI をアクティブ信号から分離する方法を 図 8-3 に示します。N チャネル FET が WDI ピンと直列に配置され、FET のゲートは $\overline{\text{RESET}}$ 出力に接続されます。

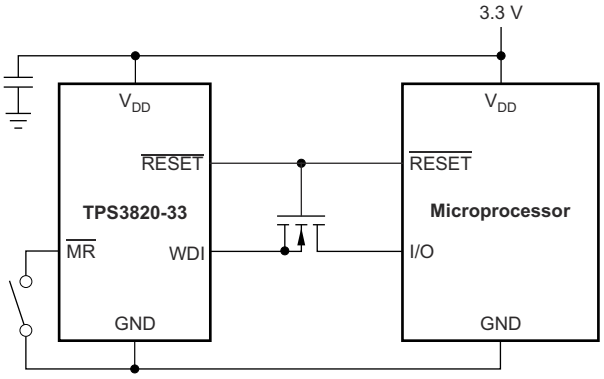


図 8-3. WDI の例

8.2.2.1 設計要件

TPS3820 は、ロジック HIGH 信号を使用してマイクロプロセッサのイネーブル ピンを駆動し、電源電圧がデバイスの最小動作電圧を上回っていることを示すとともに、I/O ピンを監視してマイクロコントローラが正しく動作しているかどうかを確認する必要があります。目的の動作を実現するには、リセット信号の遅延時間を 10ms より長く 50ms より短くする必要があります。

8.2.2.2 詳細な設計手順

電源電圧の監視に最適な TPS3820 のバージョンを決定します。

入力電源にノイズが多い場合は、リセット信号が不用意に変化することを防止するために、入力コンデンサを付けてください。

8.2.2.3 アプリケーション曲線

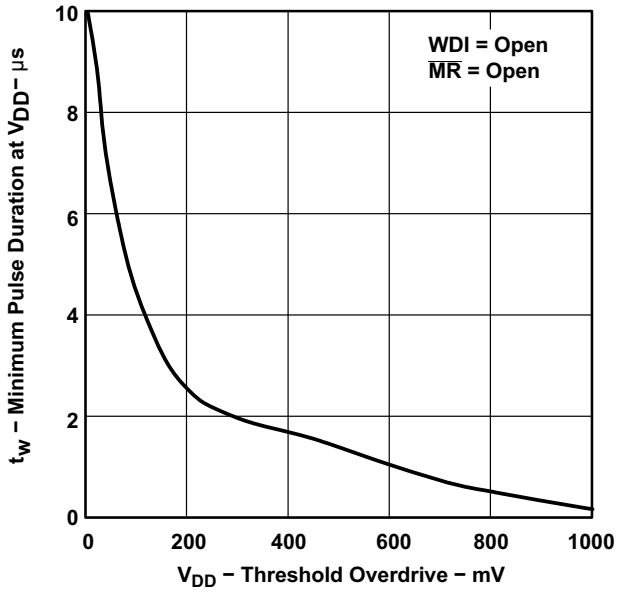


図 8-4. V_{DD} の最小パルス幅と V_{DD} スレッショルド・オーバードライブとの関係

8.3 電源に関する推奨事項

これらのデバイスは、1.1V ～ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。必須ではありませんが、適切なアナログ設計手法では、入力電源のノイズが多い場合、0.1µF セラミック コンデンサを V_{DD} ピンの近くに配置することが推奨されます。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

TPS382x ファミリのデバイスで使用するプリント基板 (PCB) のレイアウトについては、以下のガイドラインに従ってください。

- V_{DD} デカップリング・コンデンサ (C_{VDD}) は、デバイスの近くに配置します。
- V_{DD} 電源ノードには、長いトレースを使用しないでください。V_{DD} コンデンサ (C_{VDD}) は、電源からコンデンサまでの寄生インダクタンスとともに LC タンクを形成し、最大 V_{DD} 電圧を上回るピーク電圧のリンギングを発生させる可能性があります。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

8.4.2 レイアウト例

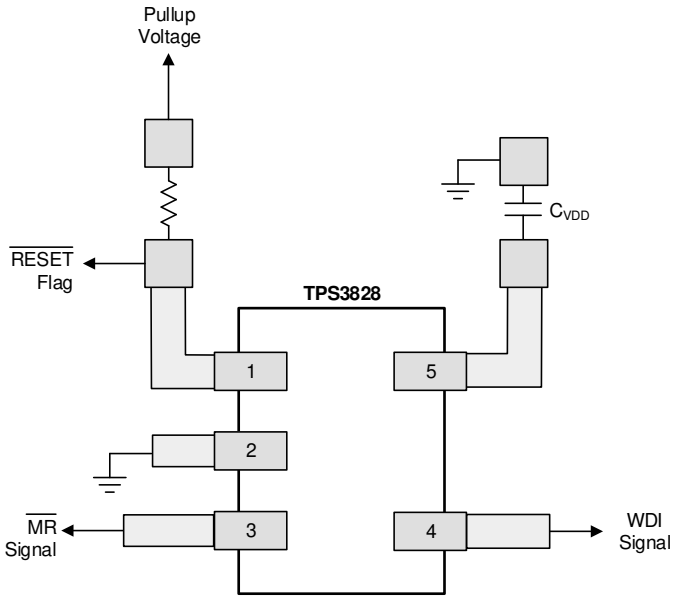


図 8-5. レイアウト例 (DBV パッケージ)

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 デバイスのサポート

9.1.1 開発サポート

9.1.1.1 SPICE モデル

SPICE による回路パフォーマンスのコンピュータ・シミュレーションは、多くの場合、アナログ回路やシステムのパフォーマンスを分析するのに有用です。TPS382x の SPICE モデルは、製品フォルダの「*ツールとソフトウェア*」から入手できます。

9.1.2 デバイスの命名規則

表 9-1. 注文情報

注文用デバイス名 (1) (2) (3)		スレッショルド電圧(4)	マーキング
TPS3820-33DBVT	TPS3820-33DBVR	2.93V	PDEI
TPS3820-50DBVT	TPS3820-50DBVR	4.55V	PDDI
TPS3823-25DBVT	TPS3823-25DBVR	2.25V	PAPI
TPS3823-30DBVT	TPS3823-30DBVR	2.63V	PAQI
TPS3823-33DBVT	TPS3823-33DBVR	2.93V	PARI
TPS3823-50DBVT	TPS3823-50DBVR	4.55V	PASI
TPS3824-25DBVT	TPS3824-25DBVR	2.25V	PATI
TPS3824-30DBVT	TPS3824-30DBVR	2.63V	PAUI
TPS3824-33DBVT	TPS3824-33DBVR	2.93V	PAVI
TPS3824-50DBVT	TPS3824-50DBVR	4.55V	PAWI
TPS3825-33DBVT	TPS3825-33DBVR	2.93V	PDGI
TPS3825-50DBVT	TPS3825-50DBVR	4.55V	PDFI
TPS3828-33DBVT	TPS3828-33DBVR	2.93V	PDII
TPS3828-50DBVT	TPS3828-50DBVR	4.55V	PDHI
TPS3823A-33DBVT	TPS3823A-33DBVR	2.93V	PYPI

(1) 最新のパッケージ情報と発注情報については、このデータシートの末尾にある「付録：パッケージ オプション」を参照するか、www.ti.com または www.tij.co.jp にある TI の Web サイトを参照してください。
(2) DBVT パッケージは 1 リールあたり 250 個のテープ リールによる供給です。
(3) DBVR パッケージは 1 リールあたり 3000 個のテープ リールによる供給です。
(4) これ以外のスレッショルド電圧を持つ製品に関しては、TI までお問い合わせください。

9.2 ドキュメントのサポート

9.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。*『TI の電圧監視 IC ファミリにおけるウォッチドッグ タイマのディセーブル』*(SLVA145)

9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

9.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.5 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.6 静電気放電に関する注意事項

この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.7 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision N (July 2022) to Revision O (March 2025) — **Page**

- 熱パラメータを更新 5
- VPOR のテスト条件を明確化 6
- MR 抵抗の標準値を更新 6
- VPOR テストの説明を明確化 7
- MR 抵抗の標準値を更新 7

Changes from Revision M (July 2020) to Revision N (July 2022) — **Page**

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新。 1

Changes from Revision L (January 2018) to Revision M (July 2020) — **Page**

- 図 6-9～図 6-26 に新しい代表的性能曲線を追加 9

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版については、左側のナビゲーションをご覧ください。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS3820-33DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDEI
TPS3820-33DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDEI
TPS3820-33DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDEI
TPS3820-33DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDEI
TPS3820-33DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	PDEI
TPS3820-33DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
TPS3820-50DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDDI
TPS3820-50DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDDI
TPS3820-50DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDDI
TPS3820-50DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDDI
TPS3820-50DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	PDDI
TPS3823-25DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAPI
TPS3823-25DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAPI
TPS3823-25DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAPI
TPS3823-25DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAPI
TPS3823-25DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PAPI
TPS3823-30DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAQI
TPS3823-30DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAQI
TPS3823-30DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAQI
TPS3823-30DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAQI
TPS3823-30DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PAQI
TPS3823-33DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PARI
TPS3823-33DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PARI
TPS3823-33DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PARI
TPS3823-33DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PARI
TPS3823-33DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PARI
TPS3823-33DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	See TPS3823-33DBVT	
TPS3823-50DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PASI
TPS3823-50DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PASI

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS3823-50DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PASI
TPS3823-50DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PASI
TPS3823-50DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PASI
TPS3823-50DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	See TPS3823-50DBVT	
TPS3823A-33DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PYPI
TPS3823A-33DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PYPI
TPS3823A-33DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PYPI
TPS3823A-33DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PYPI
TPS3823A-33DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PYPI
TPS3824-25DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PATI
TPS3824-25DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PATI
TPS3824-30DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAUI
TPS3824-30DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAUI
TPS3824-30DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
TPS3824-30DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PAUI
TPS3824-33DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAVI
TPS3824-33DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAVI
TPS3824-33DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAVI
TPS3824-33DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAVI
TPS3824-33DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PAVI
TPS3824-50DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAWI
TPS3824-50DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAWI
TPS3824-50DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAWI
TPS3824-50DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PAWI
TPS3824-50DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-	PAWI
TPS3825-33DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDGI
TPS3825-33DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDGI
TPS3825-33DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDGI
TPS3825-33DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDGI
TPS3825-33DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	PDGI
TPS3825-33DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS3825-50DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDFI
TPS3825-50DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDFI
TPS3825-50DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDFI
TPS3825-50DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDFI
TPS3825-50DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	PDFI
TPS3825-50DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
TPS3828-33DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDII
TPS3828-33DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDII
TPS3828-33DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDII
TPS3828-33DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDII
TPS3828-33DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	PDII
TPS3828-33DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
TPS3828-50DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDHI
TPS3828-50DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDHI
TPS3828-50DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDHI
TPS3828-50DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	PDHI
TPS3828-50DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	PDHI
TPS3828-50DBVTG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS3820, TPS3823, TPS3824, TPS3825, TPS3828 :

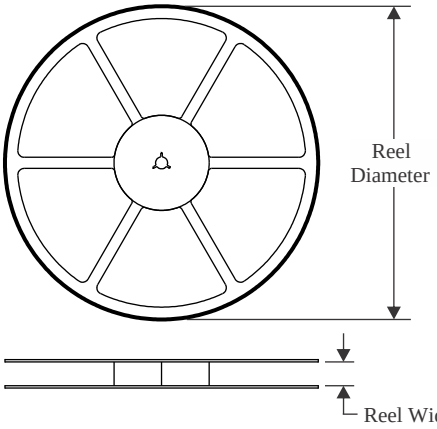
- Automotive : TPS3820-Q1, TPS3823-Q1, TPS3824-Q1, TPS3825-Q1, TPS3828-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

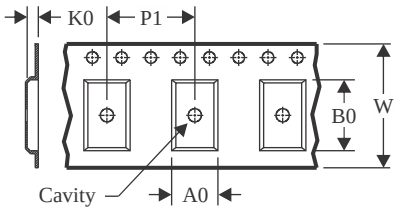
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

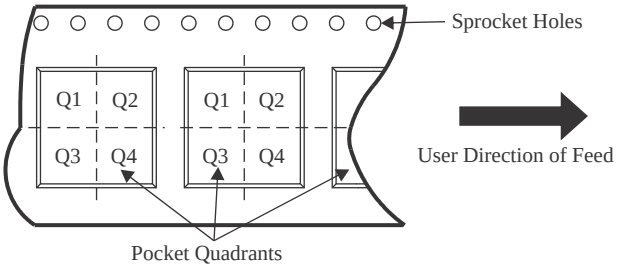


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

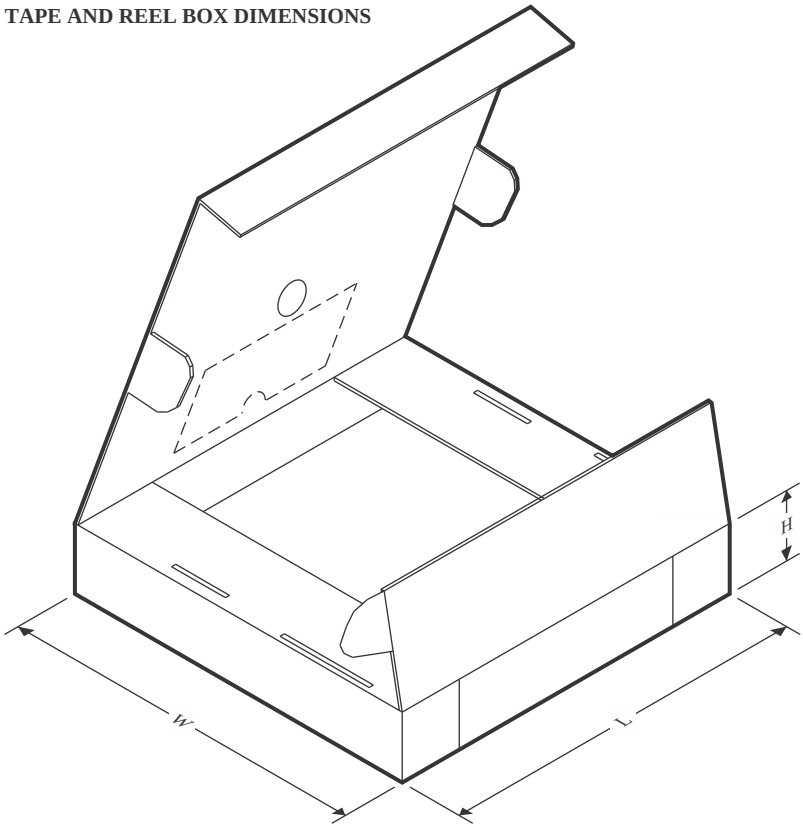


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS3820-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3820-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3820-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3820-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3820-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-25DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-25DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3823-25DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-30DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-30DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3823A-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3823A-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS3824-25DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3824-25DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3824-30DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3824-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3824-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3824-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3824-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3825-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3825-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3825-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3825-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3825-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS3825-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3828-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3828-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3828-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS3828-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3

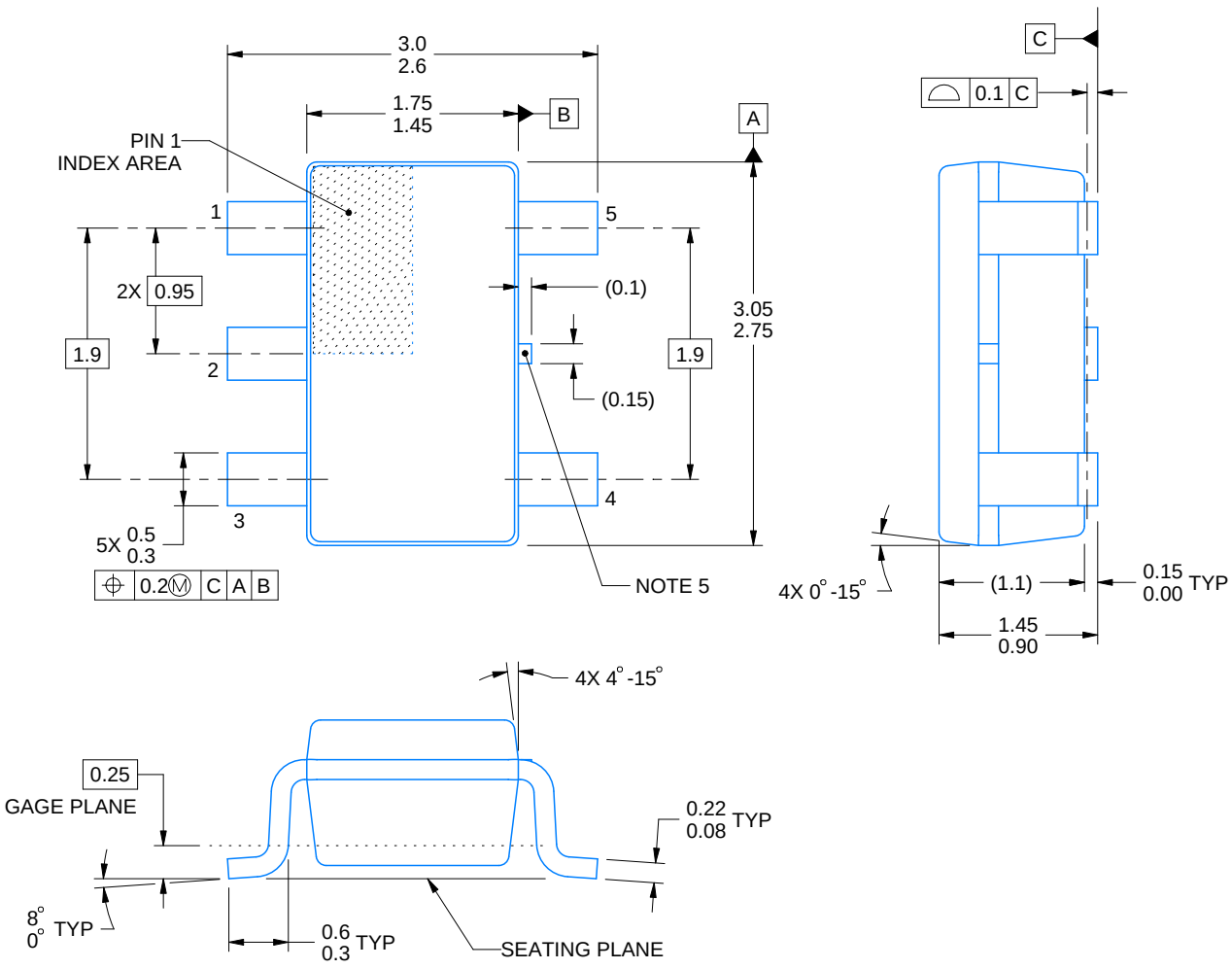
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS3820-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3820-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3820-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3820-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS3820-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-25DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-25DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	203.0	203.0	35.0
TPS3823-25DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-30DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-30DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823A-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3823A-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3824-25DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS3824-25DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0

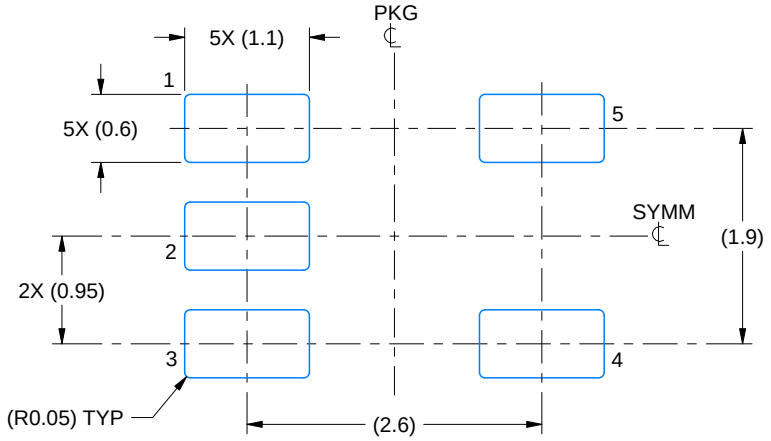
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS3824-30DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3824-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3824-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3824-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3824-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3825-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3825-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3825-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3825-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	203.0	203.0	35.0
TPS3825-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	203.0	203.0	35.0
TPS3825-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3828-33DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3828-33DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3828-50DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS3828-50DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0



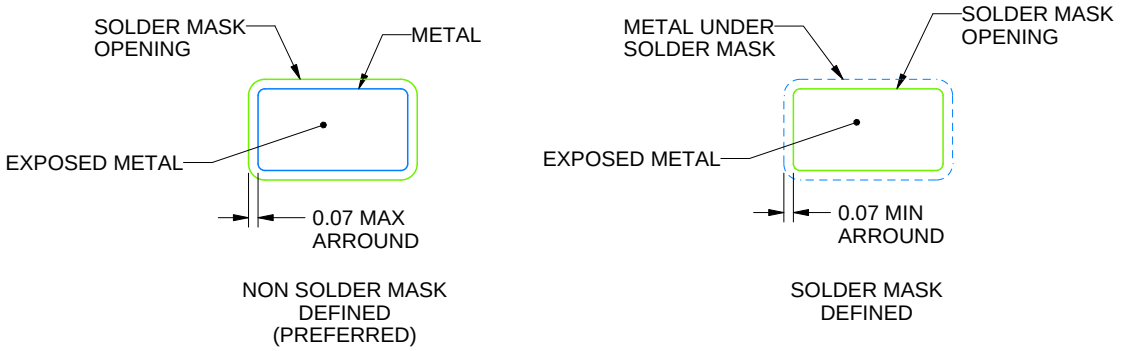
4214839/K 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

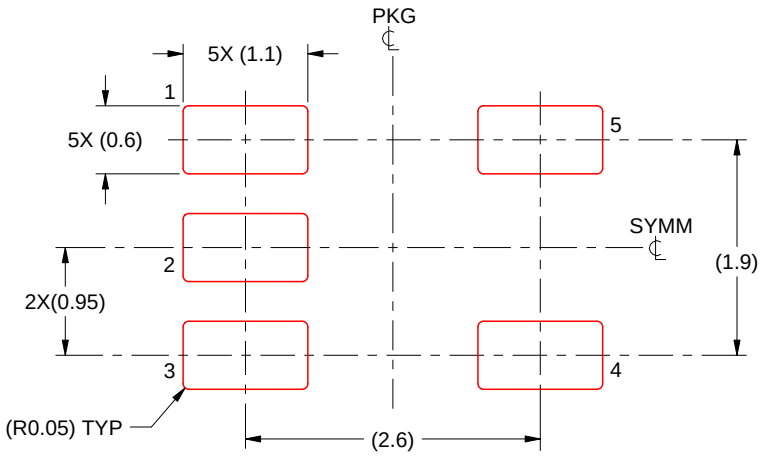


SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス· インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、 テキサス· インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス· インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス· インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、 テキサス· インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。 テキサス· インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、 テキサス· インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、 テキサス· インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス· インスツルメンツの製品は、 テキサス· インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス· インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。 テキサス· インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス· インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、 テキサス· インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated